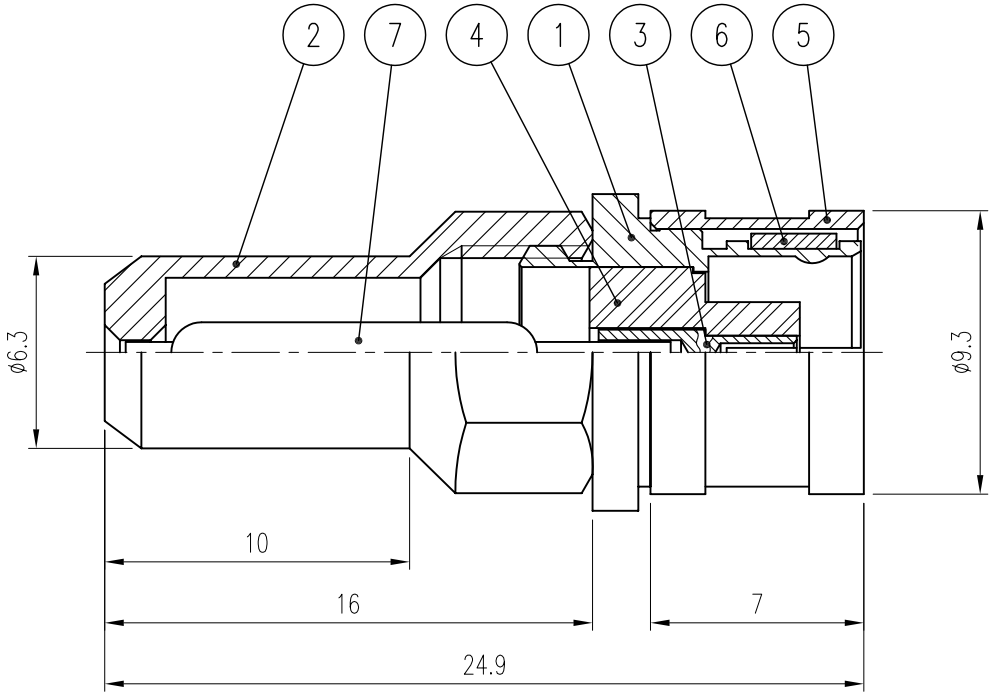
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
6	SPRING RING	1	MBsBD	Gold Plate	DSR00010-N45/1 (R4001)
5	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00043-135/1 (K4002)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00390-N/1 (H4024)
3	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00438-1345/1 (E4003)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00560-135/1 (D4030)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00552-135/1 (D4029)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질 _____

열처리 _____

보호피막처리 _____

년월일 2000. 2. 16.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 4/1 단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMZ-P-DUMMY

A4

도번 TM00084-7/1

K317-902-000